

2018年8月22日

報道関係各位

一般社団法人 電子情報技術産業協会

半導体部会、地震対策のための半導体工場向け技術事例集を公開

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の半導体部会（部会長：ソニー株式会社 執行役員 技術渉外担当 上田 康弘）は、本日、半導体部会加盟各社の技術・ノウハウを集積した「地震対策技術事例集」を公開したことを発表しました。同事例集については、JEITAのホームページよりダウンロードも可能となっており、URLは下記の通りです。

ダウンロード URL : <https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=715&cateid=5>

JEITA 半導体部会は、東日本大震災や熊本地震などの教訓から、2016年8月に半導体部会内に Business Continuity Management - Task Force (BCM-TF) を結成、各社の技術・ノウハウを集積した地震対策技術事例集を本年1月に作成し、TFメンバーで共有すると共に、全国2か所でセミナーを開催し、半導体関連のサプライチェーン企業への展開を進めてきました。これらの震災における被害や対策事例、設備の耐震強化施策および情報共有の手法の内、比較的少ない費用で効果の大きいものは、広く社会に共有すべき資産であると判断して、このたびホームページで公開することに致しました。本事例の公開を決めた目的と背景について、半導体部会長の上田は次のように語っています。

「日本に生産拠点を有する企業にとって、災害対策は協調領域であり、サプライチェーンの維持には相互協力が欠かせません。各社が持つ経験や知見・技術が本事例集を通じて広く社会全体で共有されることにより、災害に対する有効な備えの強化を促し、災害に強い体制構築の一助になることを願っています。」

JEITA 半導体部会は業界団体として、健全な競争を尊重しつつ、様々な取り組みを通じて顧客および社会に貢献し、業界の発展に繋げてまいります。今後の取り組みにつきましては、随時発表いたします。

【本件に関する企業/団体からのお問い合わせ先】

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）電子デバイス部（担当：井上）
TEL：03-5218-1061 E-mail：sspg@jeita.or.jp

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）企画管理部 広報室（担当：吉田）
TEL：03-5218-1053 E-mail：press@jeita.or.jp